

# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 2017年度业绩说明会会议纪要

时 间： 2018 年 4 月 10 日 15:00-16:30

召开方式： 网络互动形式

参会人员： 公司董事长兼总经理王蔚先生

公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生

在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

**1、投资者提问： 王总好，公司内销外销毛利差异巨大，能否说明一下具体情况？**

答：您好，内销与外销的产品结构存在差异，内销以芯片级封装业务为主，该业务的收入包含芯片本身的价格，而外销的销售收入只是加工服务费。

**2、投资者提问： 公司前五大客户集中度很高，是否意味着更大的风险？**

答：您好，前五大客户销售占比较高主要是由于芯片设计环节的高集中度格局所致。公司前五大客户均为传感器领域主流设计公司，系公司的核心客户群与市场竞争优势所在。

**3、投资者提问： 公司和其他三家上市友商相比，营收规模相对较小，而营收增速也略微落后。王总能否谈谈晶方科技在 OSAT 业内与众不同的地方？比如公司定位？发展方向？**

答：您好，公司主要专注于传感器领域，其他几家以 CPU、Memory 等主流 IC 领域为主。同时，公司采用的技术也不同，公司主要采用 WLCSP 技术，所覆盖产业链环节存在差异。最后，各家的核算模式也存在差异。

**4、投资者提问： 公司未来有高送转计划吗**

答：您好，2017 年度的分配情况请您关注公司于上交所网站披露的《晶方科技关于 2017 年度利润分配预案的公告》（临 2018-017）。

**5、投资者提问：公司连续4年每年1亿左右占营收高比例的研发费用支出，并没有反映在对业务收入和利润的增速提升上。请问王总，这些研发费用是投向更先进的封装技术的储备上，还是为满足现有订单生产过程中必要的技改中支出的？能详细说明一下吗？**

答：（1）传感器产品的市场与技术变革日益加快，为此公司需对生产工艺、材料、设备等不断进行创新与开发，以适应市场与技术的发展需求。

（2）公司持续加强对汽车电子领域的技术开发（汽车领域开发周期较长，一般2-3年）。

（3）公司在不断开发投入FAN-OUT技术，2018年开始预计会实现小规模量产。

（4）在过去2年中公司一直积极加强在3D领域的布局与开发。

以上几个方面使得公司的技术研发与工艺开发的投入较大。

**6、投资者提问：请问王总，TSV和生物身份识别技术的发展情况，以及应用市场的开拓情况能否介绍一下？您认为公司未来的成长点在哪里？**

答：您好，公司为生物身份识别技术的领先开发与制造者，拥有多样化的生物身份识别技术，未来的主要发展方向在屏下指纹和超薄指纹（都应用在手机正面），这些技术无论在技术和市占率均处于显著领先地位。随着生物身份识别在手机正面应用的日益普及，对公司在该领域的业务增长带来正面积极作用。

感谢投资者参加公司2017年度业绩说明会，公司将继续通过网络平台加强与各位投资者的沟通和交流，非常愿意听取投资者朋友对公司发展的建议和意见，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持！

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2018年4月11日